

Title (en)  
Method for recycling an abrasive suspension

Title (de)  
Verfahren zum Wiederaufarbeiten einer Schleifsuspension

Title (fr)  
Procédé pour le recyclage d' une suspension abrasive

Publication  
**EP 0916463 A1 19990519 (DE)**

Application  
**EP 98118106 A 19980924**

Priority  
DE 19743721 A 19971002

Abstract (en)  
[origin: DE19743721A1] An used grinding suspension is treated by drying to separate cutting liquid and then classifying to separate cutting grains from debris. Reprocessing of an used grinding suspension, which comprises cutting grains and debris dispersed in a cutting fluid and which is used for machining silicon, quartz or ceramic, comprises drying to separate the liquid component from the solid components which are then classified to separate the cutting grains from the debris.

Abstract (de)  
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Wiederaufarbeitung einer gebrauchten, bei der mechanischen Bearbeitung von Silicium, Quarz oder Keramik verwendeten Schleifsuspension, bestehend aus einer Schneidflüssigkeit, in der ein Schneidkorn und Abrieb dispergiert sind, welches dadurch gekennzeichnet ist, daß in einem ersten Verfahrensschritt die Schleifsuspension über einen Trocknungsschritt schonend in eine Fest- und eine Flüssigkomponente getrennt wird und in einem zweiten Verfahrensschritt die Festkomponente durch an sich bekannte Klassierverfahren in Schneidkorn und Abrieb getrennt wird.

IPC 1-7  
**B28D 1/02**; **B24B 55/12**; **B24B 37/04**

IPC 8 full level  
**B24B 57/00** (2006.01); **B24B 37/04** (2012.01); **B24B 55/12** (2006.01); **B28D 1/02** (2006.01); **C09K 3/14** (2006.01); **C10M 175/04** (2006.01)

CPC (source: EP KR US)  
**B24B 37/04** (2013.01 - EP KR US); **B24B 55/12** (2013.01 - EP KR US); **B28D 1/025** (2013.01 - EP KR US); **C10M 175/04** (2013.01 - EP KR US)

Citation (search report)

- [X] EP 0502461 A1 19920909 - FORACON MASCH & ANLAGEN [DE]
- [X] EP 0742079 A1 19961113 - ECOTOP GES FUER INNOVATIVE ABF [DE], et al
- [A] EP 0767035 A1 19970409 - NIPPEI TOYAMA CORP [JP], et al
- [A] EP 0786317 A2 19970730 - SHINETSU HANDOTAI KK [JP]
- [A] US 5647989 A 19970715 - HAYASHI YOSHIHIRO [JP], et al
- [AD] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 14, no. 119 (M - 945) 6 March 1990 (1990-03-06)

Cited by  
DE10338520A1; DE19960380A1; DE19960380C2; US7591376B2

Designated contracting state (EPC)  
DE FR GB IT

DOCDB simple family (publication)  
**DE 19743721 A1 19990408**; EP 0916463 A1 19990519; JP H11172236 A 19990629; KR 19990036687 A 19990525; US 6010010 A 20000104

DOCDB simple family (application)  
**DE 19743721 A 19971002**; EP 98118106 A 19980924; JP 28006298 A 19981001; KR 19980040113 A 19980926; US 16490398 A 19981001